



2019年12月期第1四半期 決算説明資料

株式会社RS Technologies

2019/5/15

代表取締役社長 方 永義



東証1部
3445

目次

2019年第1四半期決算概要 P.3

2019年12月期第1四半期決算概要

セグメント別動向

財務諸表

会社概要 P.7

会社概要

沿革

現在のRS Technologies

再生ウェーハ事業の地域別売上構成比

代表取締役方永義の強み

Appendix P.13

中期経営計画(4か年)の概要

RS Technologiesの目指す世界

今後のウェーハ戦略

設備投資計画

中国の半導体政策

2019年12月期 決算見通し

再生ウェーハビジネス (1)

再生ウェーハビジネス (2)

プライムウェーハビジネスに進出

2019年12月期第1四半期決算概要

2019年12月期第1四半期決算概要

- プライムウェーハ事業及び半導体関連装置・部材等事業が好調であったことが増収増益に寄与。
- 2019年1月にDGテクノロジーズを連結子会社化し、半導体関連装置・部材等事業を強化。

(百万円)	2018年12月期 第1四半期	2019年12月期 第1四半期	前年同期比	差額
売上高	5,193	6,311	+21.5%	+1,118
営業利益	1,188	1,414	+19.0%	+226
営業利益率	22.8%	22.4%		△0.4pt
経常利益	910	1,373	+50.8%	+463
経常利益率	17.5%	21.7%		+4.2Pt
親会社株主に帰属する 当期純利益	463	819	+76.8%	+356
一株当たり四半期純利益	41.01円	64.01円	+56.0%	+23.00円

2019年12月期第1四半期累計決算概要 セグメント別動向

■北京工場（プライムウェーハ製造販売事業）が好調に推移したことが収益に大きく寄与。

セグメント別 (百万円)	ウェーハ事業		プライムウェーハ製造 販売事業		半導体関連装置・ 部材等		その他・調整額		連結合計	
		前期比		前期比		前期比		前期比		前期比
売上高	2,522	+0.4%	3,046	+20.4%	816	+238.5%	△75	—	6,311	+21.5%
営業利益	908	+1.5%	730	+80.2%	37	△7.5%	△262	—	1,414	+19.0%
営業利益率	36.0%	+0.4pt	23.9%	+7.9pt	4.5%	△12.0pt	—	—	22.4%	△0.4pt

財務諸表

- DGテクノロジーズの子会社化、及び、海外子会社にてIFRS16号（リース）を適用したことにより、資産及び負債・純資産合計が拡大。

連結貸借対照表		
(百万円)	2018年12月期	2019年12月期 第1四半期
資産の部		
流動資産	26,074	28,731
現金及び預金	14,879	17,601
受取手形及び売掛金	6,958	6,793
商品及び製品	1,343	1,424
固定資産	10,516	14,391
有形固定資産	8,963	10,795
無形固定資産	1,099	3,144
投資その他資産	453	452
資産合計	36,591	43,123
負債の部		
流動負債	4,979	5,730
支払手形及び買掛金	1,554	1,591
有利子負債	964	1,466
固定負債	2,474	4,953
長期借入金	1,848	2,788
負債合計	7,453	10,683
純資産の部		
純資産	29,137	32,439
負債・純資産合計	36,591	43,123

会社概要

会社概要

- 半導体再生ウェーハで世界市場シェア3割のトップ企業。
- 中国中央政府直属企業との合併事業でプライムウェーハ事業にも本格進出。
- M&Aによりシナジーの期待できる周辺事業領域にも事業を拡大

社名	株式会社RS Technologies
設立	2010年12月10日
経営理念	「地球環境を大切にし、世界の人々に信頼され、常に創造し挑戦する。」
事業内容	電子材料、電子機器部品、通信機器部品材料の製造、加工、再生、販売。太陽光発電事業。中古半導体設備の買取及び販売事業。半導体材料・パーツの販売。半導体シリコンウェーハ製造の技術コンサルティング。
本社所在地	東京都品川区大井1-47-1 NTビル 12F
三本木工場	宮城県大崎市三本木音無字山崎26-2
資本金	5,373百万円（2019年3月末時点）
代表取締役	方 永義
連結子会社	艾爾斯半導体股份有限公司（台湾）2014年2月設立 資本金 NT \$300 million
	北京有研RS半導体科技有限公司（北京）登録資本 US \$138 million 出資比率 45%
	株式会社ユニオンエレクトロニクスソリューション 資本金 27百万円 出資比率 100%
	株式会社DG Technologies 資本金 100百万円 出資比率 100%

沿革

- 2010年 事業開始。再生ウェーハ事業で世界トップ。
- 2018年 中国の大手プライムウェーハメーカーを連結子会社化、ウェーハ総合メーカーに。

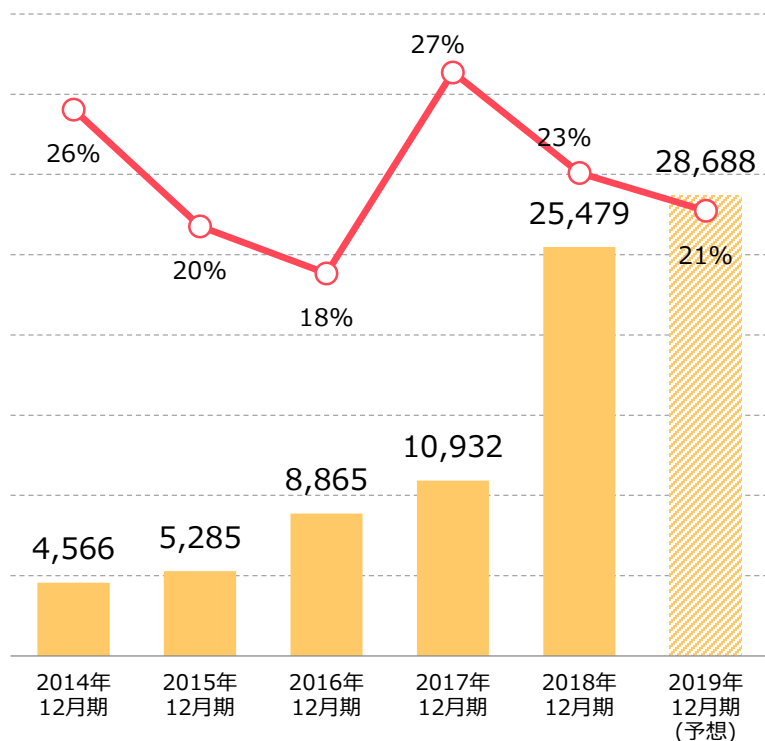
2010年（平成22年）12月	東京都品川区において、シリコンウェーハ再生事業を主たる事業として株式会社 RS Technologiesを設立
2011年（平成23年）1月	三本木工場において操業開始
2011年（平成23年）11月	三本木工場がUKASより「ISO9001:2008」（品質マネジメントシステム）認証取得
2013年（平成25年）3月	機械販売事業開始
2013年（平成25年）10月	三本木工場においてソーラー事業を開始
2014年（平成26年）2月	台湾に子会社として艾爾斯半導體股份有限公司（現・連結子会社）を設立
2015年（平成27年）3月	東京証券取引所マザーズに株式を上場
2015年（平成27年）6月	最先端設備（450mmウェーハ再生可能）を導入した三本木工場・第8工場が竣工
2015年（平成27年）10月	第13回「デロイト トウシュ トーマツ リミテッド 日本テクノロジー Fast50」において成長率1299.53%を記録し3位受賞
2015年（平成27年）12月	艾爾斯半導體股份有限公司（現・連結子会社）の台南工場が竣工
2016年（平成28年）9月	東京証券取引所市場第一部（東証一部）へ市場変更
2017年（平成29年）12月	北京有色金属研究総院及び福建倉元投資有限公司と三社間で合併契約を締結
2018年（平成30年）1月	北京有研RS半導体科技有限公司を設立、中国プライムウェーハ製造メーカーである有研半導体材料有限公司を連結子会社化
2018年（平成30年）5月	株式会社ユニオンエレクトロニクスソリューションの100%株式を取得(日立パワーデバイスの特約店)
2018年（平成30年）8月	山東有研半導体材料有限公司(有研半導体材料有限公司の連結子会社)を設立
2019年（平成31年）1月	株式会社DG Technologiesの100%株式を取得

現在のRS Technologies

- 再生ウェーハ事業+プライムウェーハ製造販売事業の総合ウェーハメーカー。
- 半導体関連装置・部材等事業 及び ソーラー事業を展開。
- 再生ウェーハ事業は世界シェアNo1、プライムウェーハ事業で中国国内向けに事業を展開。

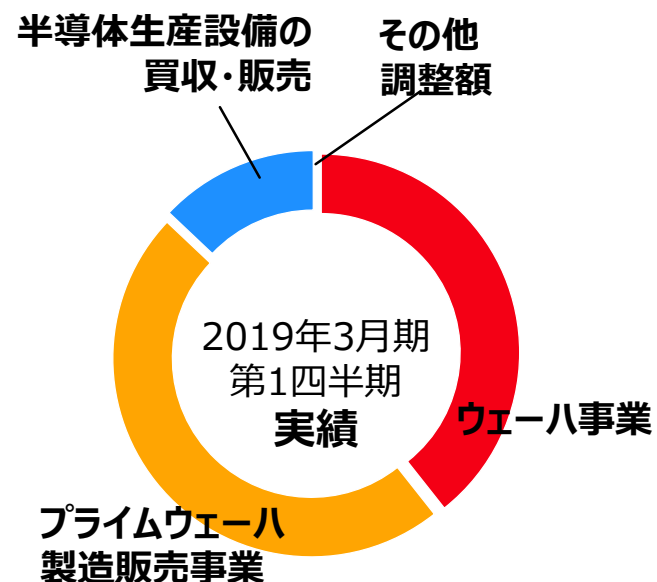
連結売上高および営業利益率

(百万円)



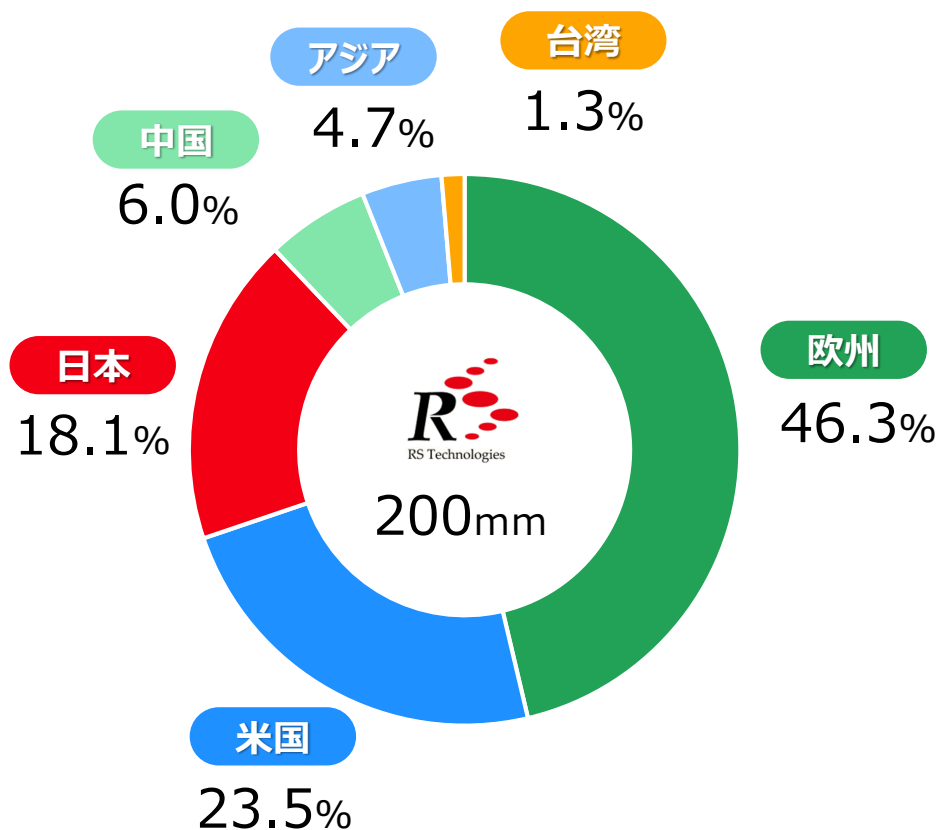
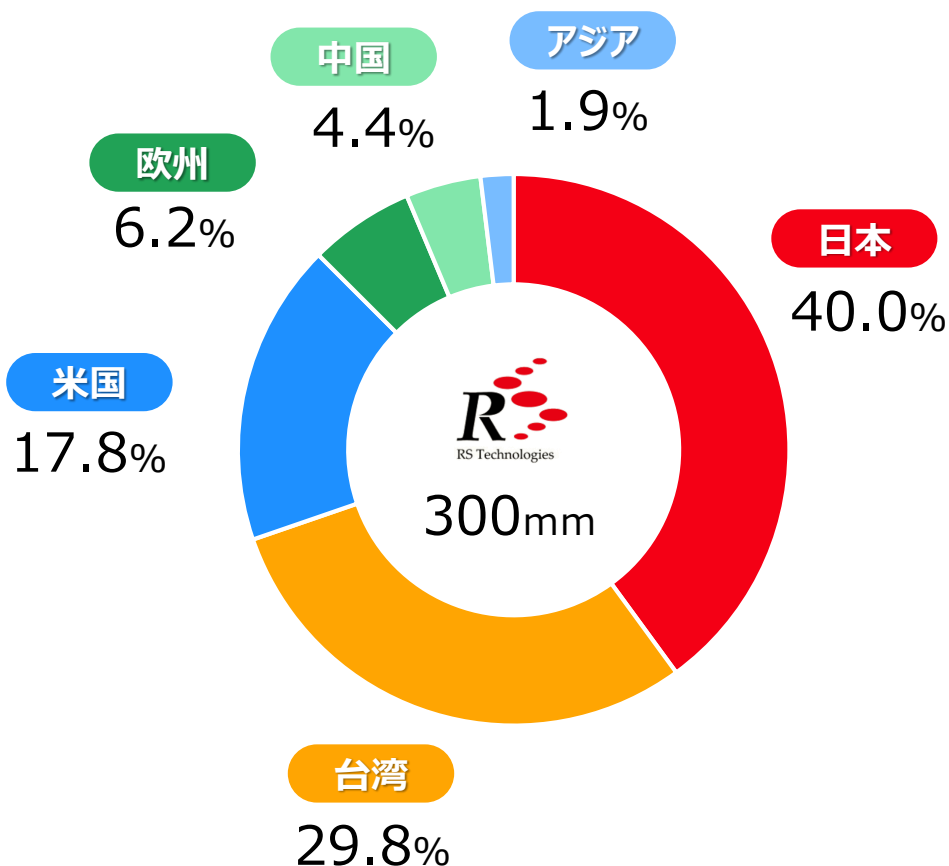
*2015年12月期～2017年12月期の決算数値は2019年3月5日にリリースした訂正後の数値となっております

セグメント別売上高



再生ウェーハ事業の地域別売上構成比

- 日本、台湾、欧米メーカー向けを中心にグローバルに展開。
- 2019年は日本、台湾での300mm設備投資により再生ウェーハの生産能力を増強。
- 300mmは北米、台湾、日本、欧州向け出荷の拡大を予定。
- 中国についてはシェアが低く、今後拡大の余地あり。



注：RST調べ、枚数ベース(2018年度)

代表取締役 方永義の強み

- 代表取締役社長である**方永義**が20年以上にわたって日本で培った知見と自身が持つネットワークを生かした全世界への販売力・人脈力・提携力・資金力が強み。
- 方永義の下にハイテクや金融など幅広い分野のプロフェッショナル人財が集結。



方永義は 前列中央 (2016年9月、東京証券取引所にて撮影)

方 永義 (ほう ながよし)

1970年生まれ 中国福建省出身
城西国際大学院 修了

得意分野：
M & A、業務提携 (過去10社を超えるM & Aを成功)

1998年 永輝商事設立
2010年 当社設立社長就任 (現任)

大切にしている心：**為せば成る**

補足：

高校卒業後に来日。日本国内外で20以上の会社の投資経験。「半導体事業」の他、ファンドや貿易、ホテル、IT事業、農業等様々な業界の投資を経験。「日本のものづくりは世界一」との信条の元、それを世界に広めていくため、世界中を飛び回っている。

Appendix

中期経営計画（4か年）の概要

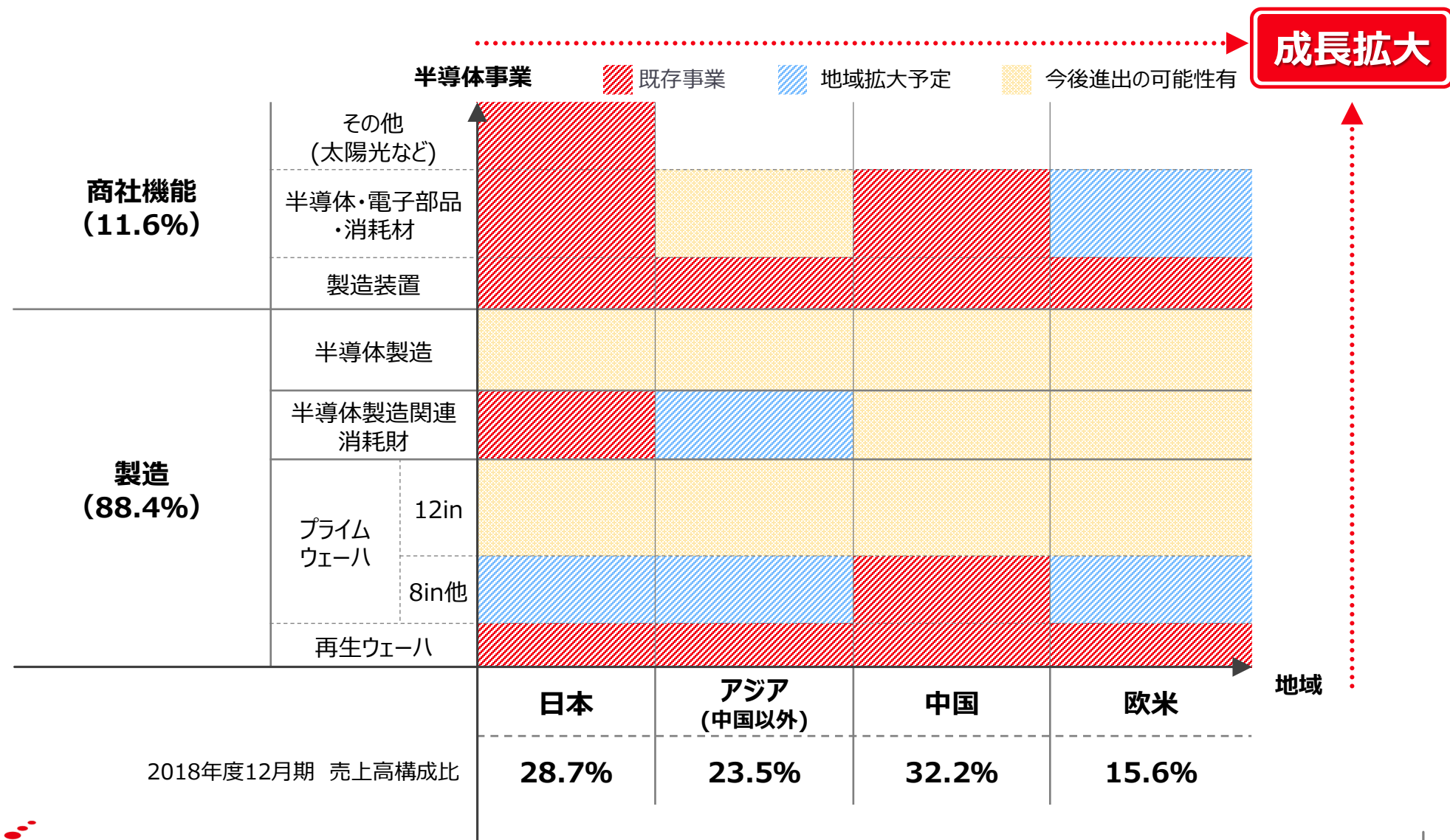
- 再生ウェーハメーカーとしてシェアアップを図るとともに、中国でのプライムウェーハ事業の本格拡大がスタート
- 再生ウェーハは生産増強を更に進め、プライムウェーハでは、工場の新設・移設を進めるのとあわせて、品質のグローバル化および生産能力アップを進展させる。

	2018年 12月期	2019年 12月期 計画		2020年 12月期 計画		2021年 12月期 計画		2022年 12月期 計画
	実績	従来	新規	従来	新規	従来	新規	新規
売上高	25,478	21,000	28,688	25,000	29,000	29,000	30,600	33,800
営業利益	5,751	3,600	5,971	4,800	6,100	6,300	6,600	8,300
営業利益率	22.6%	17.1%	20.8%	19.2%	21.0%	21.7%	21.6%	24.6%
経常利益	6,141	3,900	6,151	4,700	6,300	6,200	6,600	8,400
経常利益率	24.1%	18.6%	21.4%	18.8%	21.7%	21.3%	21.6%	24.9%
親会社株主に 帰属する 当期純利益	3,620	2,500	3,621	2,900	3,700	3,800	3,900	4,700
一株当たり 当期純利益	294.80	195.00	282.72	226.00	288.89	296.00	304.50	366.97

※一株当たり当期純利益（計画）については2018年12月期末の発行済株式数で算出しております。

RS Technologiesの目指す世界

■ 一步一步、着実に事業領域及び販売地域を広げていく。



2019年

再生ウェーハ

300mm増産による日、台、欧、米市場への供給拡大

プライムウェーハ

BGRSでの生産効率改善による中国市場への供給拡大

2020年

~

2022年

再生ウェーハ

300mm増産による日、台、欧、米、中、市場への供給拡大

プライムウェーハ

BGRS德州工場の稼働をスタートさせ、
中国市場でのシェアアップ、世界市場への供給開始を目指す

増産余地をもつ再生ウェーハ事業

プライムウェーハ事業は世界市場への展開を視野

設備投資計画：中国の工場進出地域を変更し、能力増強へ

日本

総投資額： **21億円**

- 300mm再生ウェーハの生産能力拡充
- 2019年以降、順次稼働開始

2019年度	2020年度	2021年度
7億円	7億円	7億円

台湾

総投資額： **7億円**

- 300mm再生ウェーハの生産能力拡充
- 2019年稼働開始（従来計画通り）

2019年度	2020年度	2021年度
7億円	-億円	-億円

中国

総投資額： **160億円**

- 200mmプライムウェーハの生産能力拡充

2019年度	2020年度	2021年度
160億円		-億円

第1次計画

200mmプライムウェーハ

2019年
7万枚

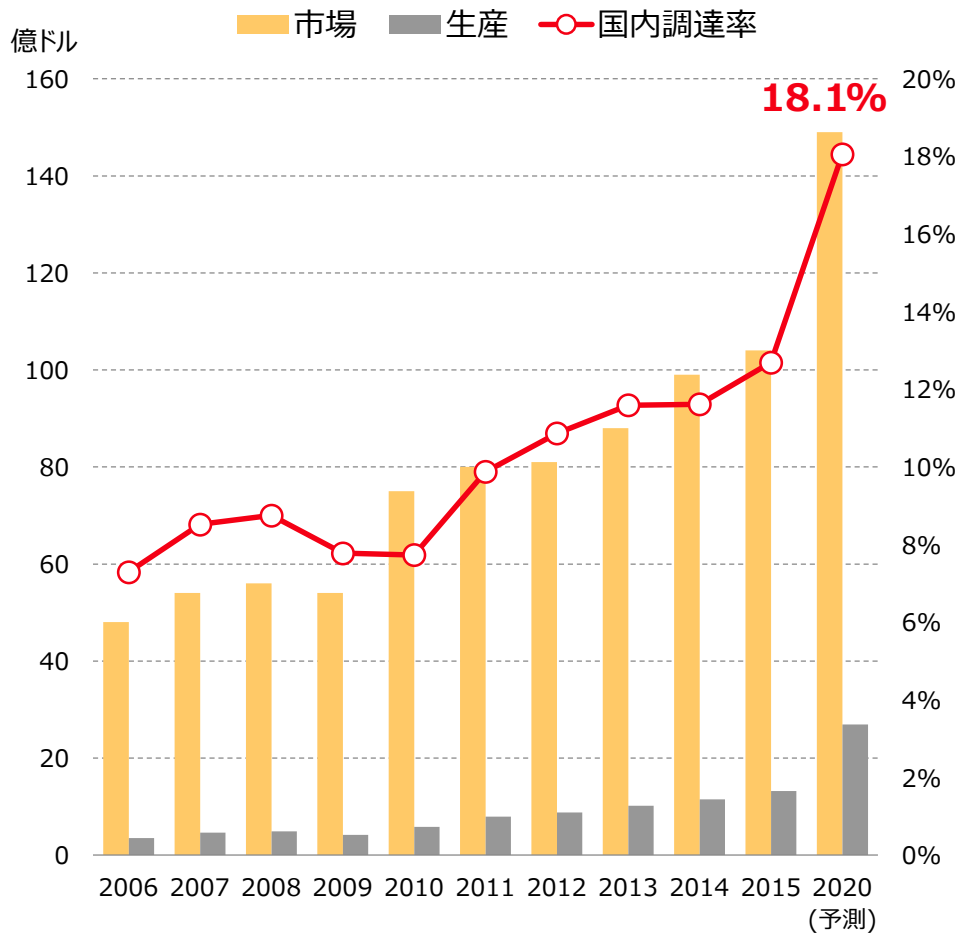


2021年
22万枚

投資期間 2019年～2021年 2021年より順次稼働開始

中国の半導体政策：国産化率のアップを目指す

中国における半導体市場および生産動向



中国の半導体消費は世界の4割を占めるまで成長
一方、国産化率はその内10%程度



国産化率の引き上げが**重要な政策課題**に

2014年6月

「**国家集成电路産業発展推進綱要**」

(国家IC産業発展推進ガイドライン)

2015年5月

「**中国製造2025**」

<以下引用> (メイド・イン・チャイナ2025)

China is aiming to improve the self-sufficiency rate for ICs in the nation to **40% in 2020**, and boost the rate further to **70% in 2025**.



目標は、

2020年に国産化率**40%**、2025年に**70%**

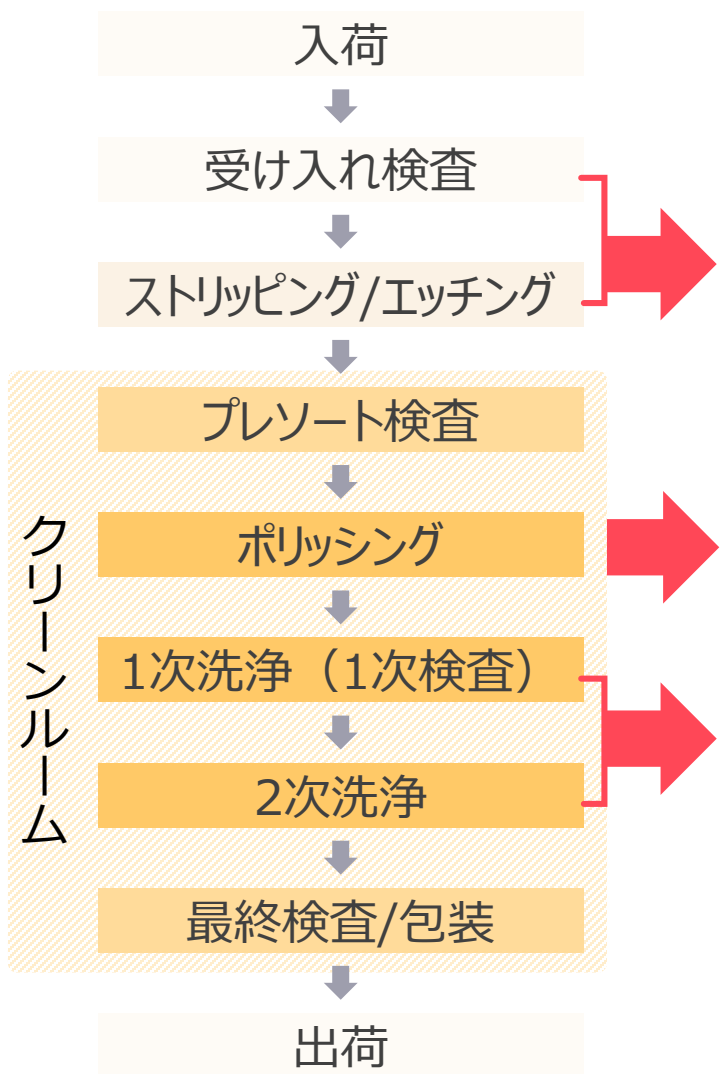
現状：生産能力の増強は急速に進展も、品質の向上に課題を残している。

2019年12月期 決算見通し

- ウェーハ単価が軟調傾向にあるものの、プライムウェーハ事業の歩留り率改善等により、大幅増収増益を達成した2018年12月期から、更に増収増益を予想。

(百万円)	2018年12月期 実績 (2018年1月～12月)	2019年12月期 予想 (2019年1月～12月)	前期比	
			増減	増減率
売上高	25,478	28,688	3,120	12.6
営業利益	5,751	5,971	220	3.8
営業利益率	22.6%	20.8%	△1.8pt	
経常利益	6,141	6,151	10	0.2
経常利益率	24.1%	21.4%	△2.7pt	
親会社株主に帰属する当期純利益	3,620	3,621	1	0.0
一株当たり当期純利益	294.80	282.72	△12.08	△4.1
年間配当金	10円	10円	—	—

(百万円)	RS		台湾子会社		北京子会社		その他子会社	連結合計	
		前期比		前期比		前期比			前期比
売上高	10,101	△4.3%	3,271	12.6%	11,867	△0.40%	3,449	28,688	+12.6%
営業利益	2,025	△23.0%	935	△3.8%	2,786	35.9%	225	5,971	+3.8%
営業利益率	20.0%	+4.9pt	28.6%	△4.9pt	23.5%	+6.3pt	6.5%	20.8%	△1.8pt



強み 1

すべての膜を剥離可能

- ケミカルによる除去の為、表面のダメージが最小限に

▶ 再生回数が多い ▶ よりコストダウンが可能

ラサ工業（化学）の特異技術を継承



表面に付いているキズや凹凸を研磨（ポリッシング）により平滑にする

強み 2

金属不純物を除去

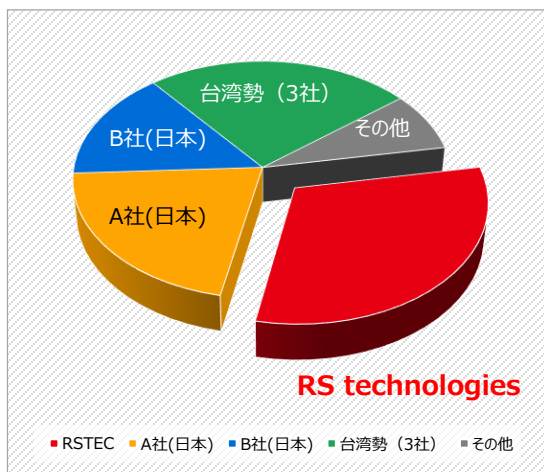
- ウェーハ表面の微細ゴミ・汚れを洗浄で取り除く
- + 金属不純物を除去 特に銅 (Cu) の除染除去に強み



再生ウェーハビジネス(2)

再生市場での当社のシェア拡大

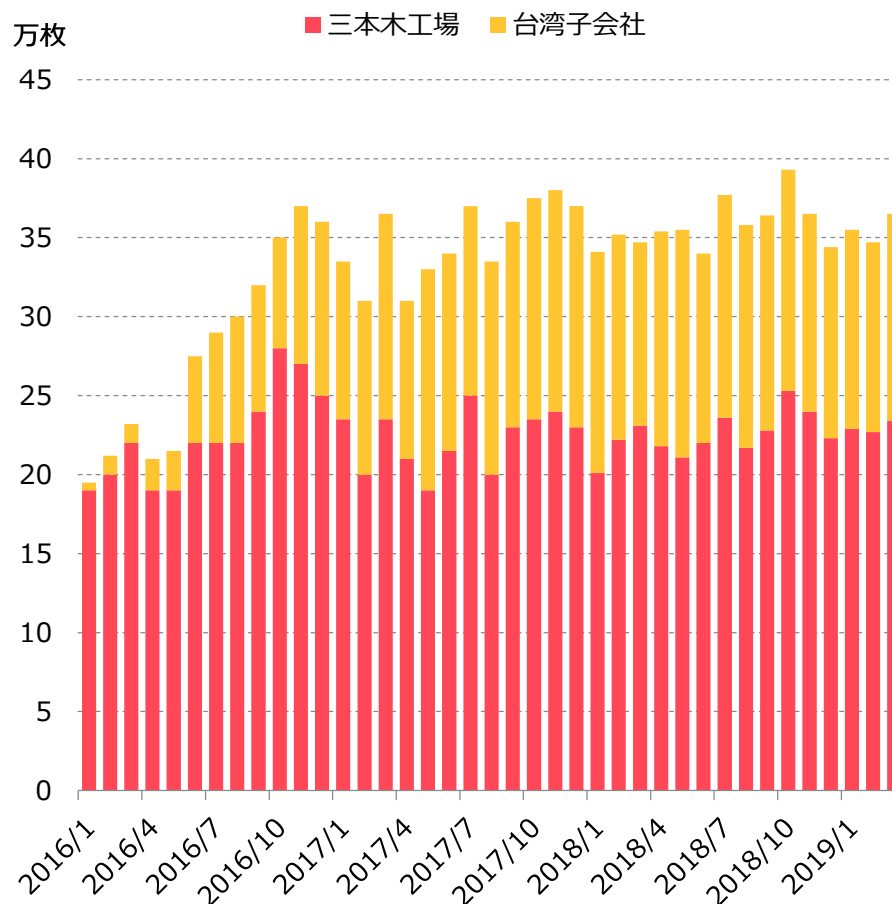
300mm再生市場における当社シェア



	2015年 上期	2015年 下期	2016年	2017年	2018年
当社グループ 生産能力	18万枚	24万枚	28万枚	30万枚	34万枚
当社グループ シェア	19%	24%	29%	30%	31%

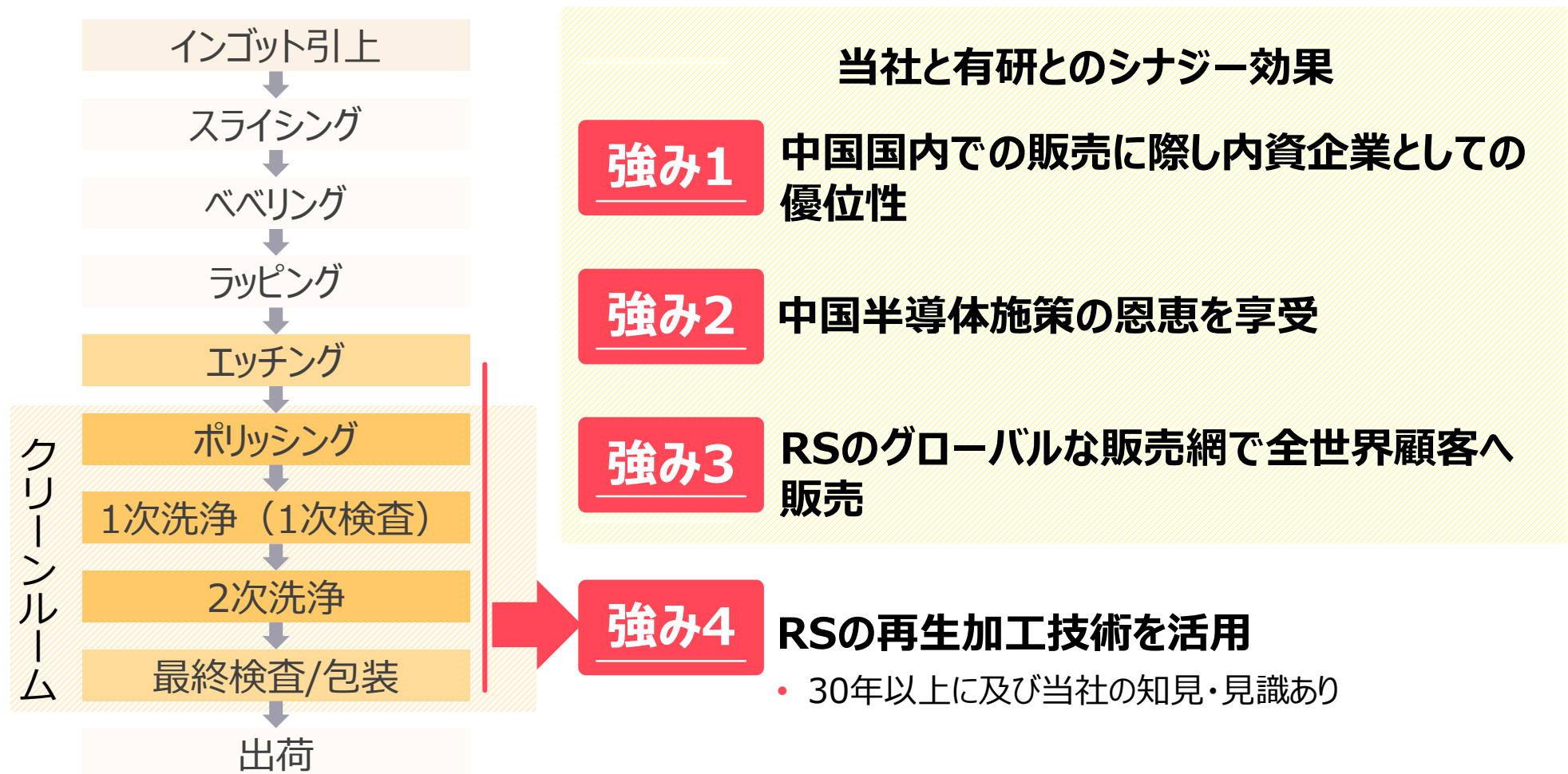
三本木工場と台湾子会社の出荷推移 (2016年-2019年)

三本木工場と台湾子会社の300mmウェーハ出荷枚数推移



プライムウェーハビジネスに進出

- 中国中央政府直属企業の北京有色金属研究総院（現 有研科技集团有限公司）との合併会社を設立。内資企業（中国の国内企業）として半導体事業を推進



当該資料に記載された内容は、一般的に認識されている経済情勢及び当社が合理的と判断した一定の前提に基づいて作成されておりますが、経営を取りまく様々な環境の変化により、予告なしに変更される可能性がございます。

本発表において提供される資料ならびに情報の中には「見通し情報」が含まれております。これらの情報は、現在における見込み、予測およびリスクを伴う想定に基づくものであり、実際には異なる結果となる不確実性を含んでおります。

今後、新しい情報・将来の出来事等があった場合であっても、当社は本発表に含まれる「見通し情報」の更新・修正をおこなう義務を負うものではありません。